

株式会社 アルバック

## 2025年6月期 決算説明資料

### 連結決算概要および業績予想 新中長期経営計画 (Value Up Plan)

2025年8月13日

#### 将来見通し等に関する記述についての注意事項

- **将来見通しについて**  
本資料に記載の業績見通しならびに将来予測は、現在入手可能な情報に基づき作成されたものです。世界経済情勢、半導体・電子部品・FPD・原材料などの市況、設備投資の動向、急速な技術革新への対応、為替レートの変動など様々な要因により、実際の業績・成果等はこれらの見通し・将来予測と大きく異なる可能性があることをご承知おきください。
- **数字の処理について**  
本資料に記載の数字・比率につきましては、単位未満四捨五入で処理しております。
- **品目名称変更について**  
2025年6月期より、FPD製造装置の名称をディスプレイ・エネルギー関連製造装置に変更しております。

ULVAC

## ■ 2025年6月期連結業績概要

- 売上高・各利益項目は概ね前回予想通りの着地、**売上総利益率 31.8%は上場来最高水準**
- 株主還元重視による安定配当の観点から、**配当は従来予想 164円を据え置き（過去最高）**

## ■ 2026年6月期業績予想

- 受注回復基調。売上高は事業改革に伴う減少があるものの、半導体電子を中心とした売上高増加等により、前年並みの高水準を維持する見込み
- 各利益項目は着実に改善を見込む

## ■ 新中長期経営計画（バリューアッププラン）

- 経営資源を最適化し、半導体電子中心の事業ポートフォリオを見直すことで、持続的な高成長・高収益性を確実に実現するため、**抜本的な改革を断行**

2026年6月期を初年度とする**新中長期経営計画“バリューアッププラン”**をスタート

まず一つ目ですが、2025年6月期の業績についてです。

売上高や各利益項目は概ね前回の予想通りに着地しまして、特に売上総利益率は31.8%と、上場以来の最高水準を達成しました。

また、株主の皆さまへの還元を重視し、安定した配当を維持するために、配当金は従来の予想通り164円で据え置きます。

次に二つ目、2026年6月期の業績予想についてです。受注は前期に比べて回復傾向にあります。

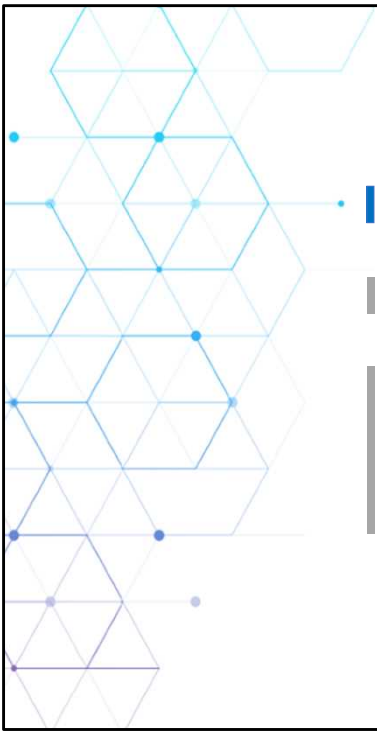
売上高については、事業改革による一部減少はあるものの、半導体電子分野を中心に売上が増加し、前年並みの高水準を維持できる見込みです。

利益面も着実に改善していく予定です。

そして三つ目、2026年6月期を初年度とする新しい中長期経営計画、バリューアッププランをスタートします。

経営資源の最適化や、半導体電子を中心とした事業ポートフォリオの見直しを進めることで、持続的な高成長と高収益性を確実に実現するため、抜本的な改革に取り組んでまいります。

具体的な方針や内容については、後ほど詳しくご説明させていただきます。



・ | **2025年6月期 業績概要**

| **2026年6月期 業績予想**

| **新中長期経営計画～ Value Up Plan～**

・ **事業改革**

・ **成長戦略**

・ **生産改革**

・ **資本政策**

- » 売上高・各利益項目は概ね前回予想通りの着地、売上総利益率 31.8%は上場来最高水準
- » 25/6期配当金164円は過去最高

【単位：億円】	24/6期	25/6期	前期比		25/6期 前回予想	前回予想比 増減率
			増減額	増減率		
受注高	2,582	2,256	-326	-13%	2,300	-2%
売上高	2,611	2,512	-99	-4%	2,500	+0%
売上総利益	807	799	-8	-1%	800	-0%
率	30.9%	31.8%	+0.9pt	-	32.0%	-
販管費	509	533	+24	+5%	530	+1%
営業利益	298	265	-32	-11%	270	-2%
率	11.4%	10.6%	-0.8pt	-	10.8%	-
経常利益	298	286	-12	-4%	275	+4%
率	11.4%	11.4%	+0.0pt	-	11.0%	-
親会社株主に帰属する 当期純利益	202	167	-35	-18%	170	-2%
率	7.7%	6.6%	-1.1pt	-	6.8%	-
1株あたり配当金（円）	144	164			164	

Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

4

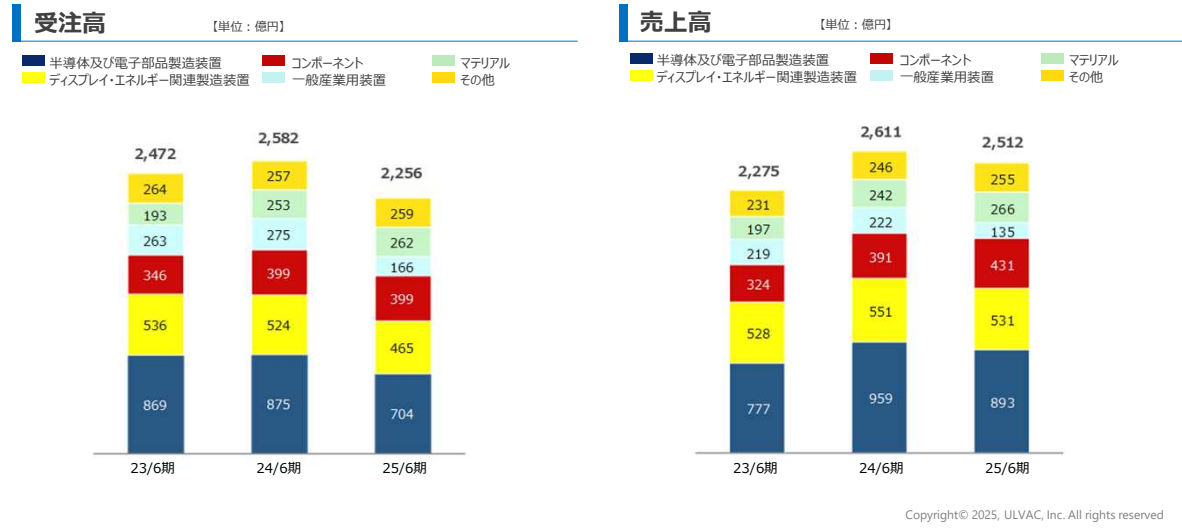
25年6月期の業績概要です。

受注高は2,256億円となり、前回予想の2,300億円に近い水準で着地しました。売上高は2,512億円となり、前回予想の2,500億円を上回る結果となりました。各利益項目も概ね前回予想通りの着地となっています。

特に売上総利益率は前期比で0.9ポイント上昇し、31.8%となりました。これは上場以来最高水準の達成となります。

また、25年6期の配当金は164円と過去最高となっております。

- » 受注高：パワーデバイス・バッテリービジネス等の投資減速により前期比減少
- » 売上高：高水準の受注残高の寄与等により、上場来2番目に高い水準で着地

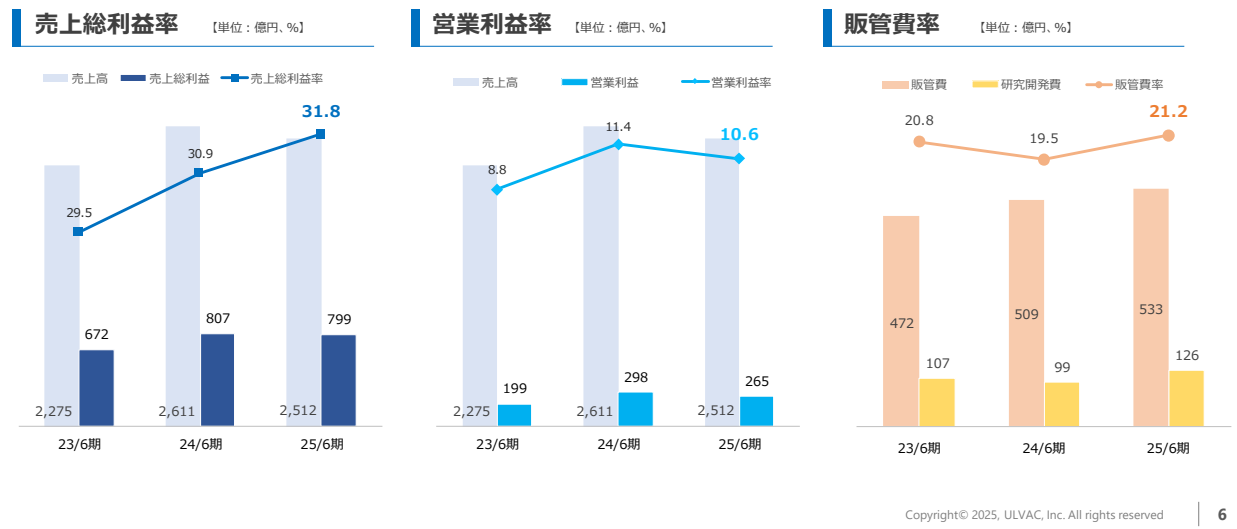


品目別ごとの受注高・売上高実績です。

左側グラフ、受注高は、下段青色の半導体電子部品において、主にパワーデバイスの投資減速、また黄色のディスプレイエネルギー関連装置では、バッテリー投資の減速を反映して、前期比減少しました。

一方、右側グラフ、売上高は、高水準の受注残高の寄与などにより、上場来2番目に高い水準で着地しました。

- ▶ 売上総利益率：ミックス改善や高利益率案件の寄与により、31.8%と上場来最高水準を達成
- ▶ 営業利益率：売上高減少および研究開発費等の増加により、前期比で営業利益率が低下



続きまして、利益率の推移です。

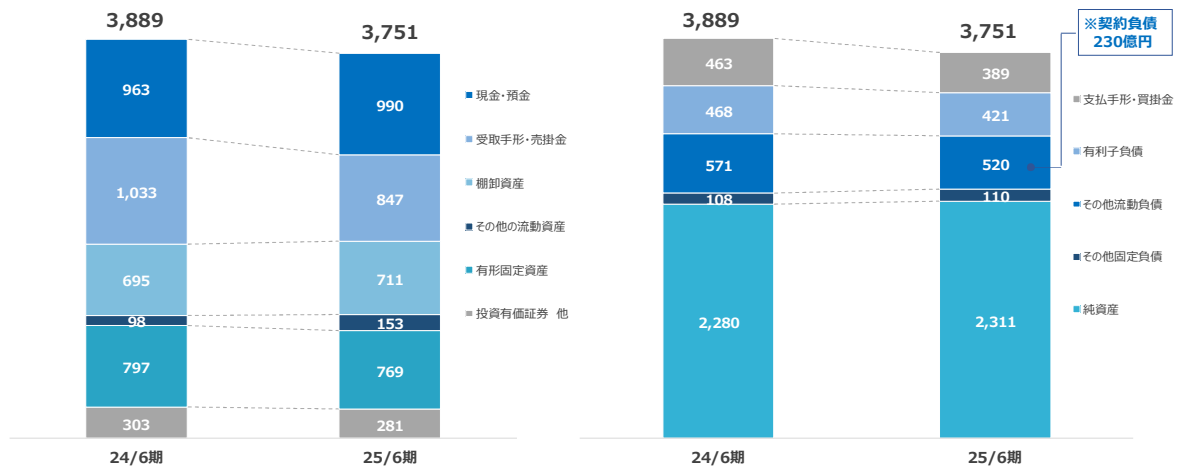
まず左のグラフですが、売上総利益率についてです。利益率の高い半導体電子・コンポーネントの売上構成比が50%を超える水準を維持しており、さらに高利益率の案件が寄与したことで、売上総利益率は31.8%となり、上場以来の最高水準を達成しました。

次に真ん中のグラフ、営業利益率についてですが、前期に比べて少し低下しています。これは売上高が減少したことに加えて、右のグラフにもありますように、今後の成長に向けた研究開発費を前期より増やしているためです。

参考までにですが、仮に研究開発費を除いた場合の営業利益率は、着実に改善している状況です。

資産【単位：億円】

負債・純資産【単位：億円】



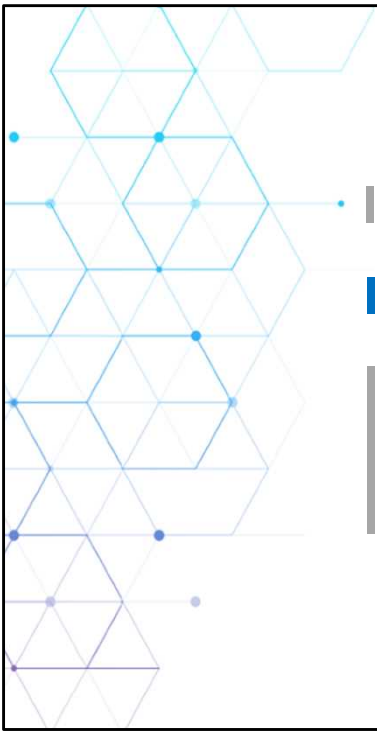
Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

こちらは、期末のバランスシートの状況です。

左側の資産については、前期比で、大型案件の売掛金回収などにより売掛金は減少しました。

右側の負債では、買掛金や有利子負債などが減少したため、現預金も3Q時点の1,073億円から990億円へと減少しています。

なお、2025年6月期の自己資本比率は59.6%となっております。



・ | 2025年6月期 業績概要

・ | 2026年6月期 業績予想

新中長期経営計画～ Value Up Plan～

・ 事業改革

・ 成長戦略

・ 生産改革

・ 資本政策

- » 受注高：半導体関連の継続投資やパワーデバイスの投資回復等により、受注は回復基調
- » 売上高・各利益(率)：受注回復、製造L/T\*短縮等により売上高は高水準で推移。各利益(率)は着実に改善を見込む

【単位：億円】	25/6期	26/6期			前期比	
		上期予想	下期予想	通期予想	増減額	増減率
受注高	2,256	1,200	1,300	2,500	+244	+11%
売上高	2,512	1,155	1,345	2,500	-12	-0%
売上総利益	799	355	470	825	+26	+3%
率	31.8%	30.7%	34.9%	33.0%	+1.2pt	-
営業利益	265	90	195	285	+20	+7%
率	10.6%	7.8%	14.5%	11.4%	+0.8pt	-
経常利益	286	90	195	285	-1	-0%
率	11.4%	7.8%	14.5%	11.4%	0.0pt	-
親会社株主に帰属する 当期純利益	167	65	135	200	+33	+20%
率	6.6%	5.6%	10.0%	8.0%	+1.4pt	-

\* L/T : Lead Time

Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

9

表の水色部分、通期予想をご覧ください。

まず受注高につきましては、半導体関連の継続投資やパワーデバイスの投資回復等により、回復基調で推移することを見込んでおり前期より244億円増の2,500億円としております。

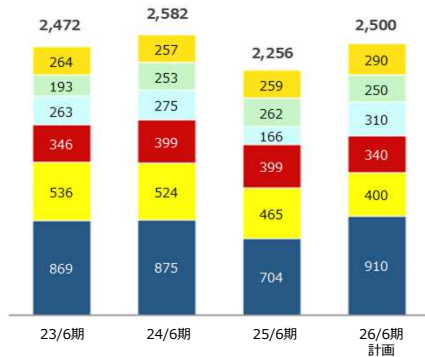
売上高につきましては、受注回復、また製造リードタイム短縮等によって前期同等の高水準を見込んでおり2,500億円を予定しています。

営業利益以下各利益につきましても、引き続き着実な改善を見込んでおります。

- » 受注高：半導体関連の継続投資やパワーデバイスの投資回復により、受注は回復基調
- » 売上高：受注回復、製造L/T短縮等により、売上高は高水準で推移

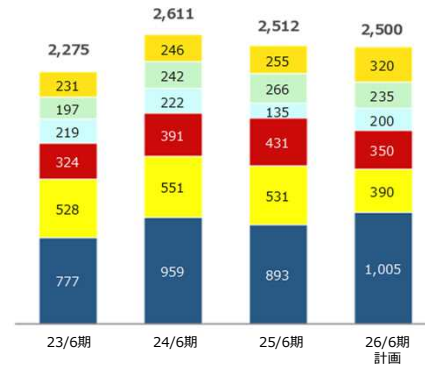
受注高 【単位：億円】

■ 半導体及び電子部品製造装置 ■ コンポーネント ■ 材料  
 ■ ディスプレイ・エネルギー関連製造装置 ■ 一般産業用装置 ■ その他



売上高 【単位：億円】

■ 半導体及び電子部品製造装置 ■ コンポーネント ■ 材料  
 ■ ディスプレイ・エネルギー関連製造装置 ■ 一般産業用装置 ■ その他



※ 26/6期より、リークテスト装置の受注高および売上高の分類を、コンポーネントから一般産業へ変更

Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

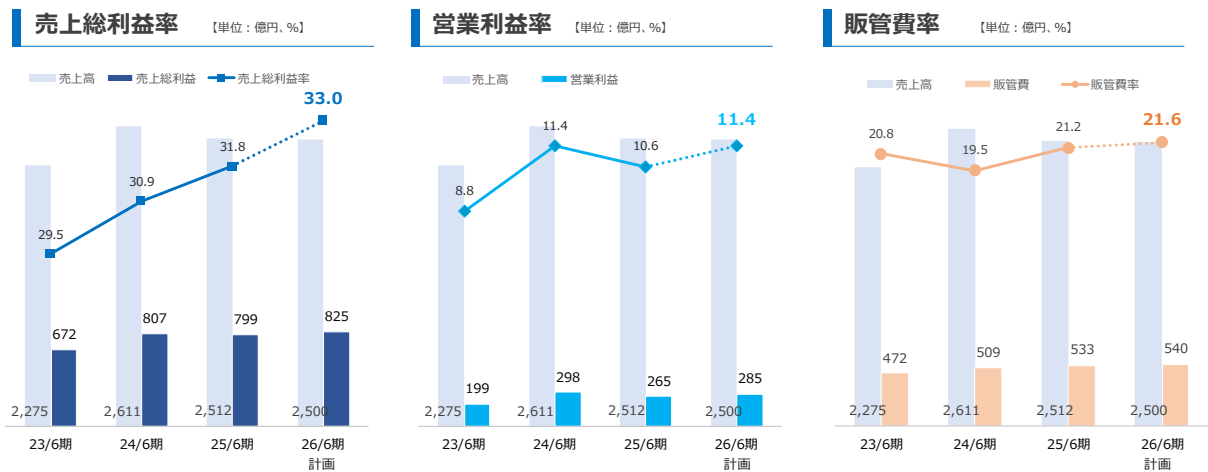
続いて、品目別ごとの受注高・売上高計画です。

左側グラフ、受注高につきましては、半導体関連の投資継続やパワーデバイスの投資回復により、特に下段青色の半導体電子部品の増加を見込むなど、受注は回復基調にあります。

右側グラフ、売上高につきましては、受注回復、製造リードタイム短縮などによって、引き続き高水準で推移すると見込んでいます。

なお、当期より、コンポーネントに含んでいた“リークテスト装置”の受注高・売上高分類を、一般産業へ変更しております。

- » 売上総利益率：半導体電子の売上高増加に伴うミックス改善効果等により着実に改善を見込む
- » 営業利益率：売上総利益率改善等により、営業利益率改善の見込み



Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

こちらは、利益率の見通しです。

左のグラフ、売上総利益率は、半導体電子の売上高増加に伴うミックス改善効果などにより、33%と着実に改善を見込んでいます。

真ん中の営業利益率も、売上総利益率の改善などにより、改善を見込んでいます。

品目	市場環境・投資動向	CY25~26
半導体 ロジック・メモリ	<ul style="list-style-type: none"> <li>DRAM：HBM関連投資継続・新規顧客投資寄与</li> <li>NAND：ストレージ需要・生成AI関連需要による拡大期待</li> <li>ロジック：次世代ノードに向けた投資本格化・MHM工程展開</li> </ul>	
各種電子デバイス	<ul style="list-style-type: none"> <li>生成AI向けWLPビジネス継続、PLP開発投資寄与</li> <li>AR/VR向け中国オプトデバイス投資貢献</li> </ul>	
パワーデバイス	<ul style="list-style-type: none"> <li>中国大手デバイスメーカーを中心に8inchSiCの投資回復見通し</li> </ul>	
ディスプレイ	<ul style="list-style-type: none"> <li>タブレット向けOLED実現に向けた設備追加・改造案件による持続的貢献</li> </ul>	
バッテリー関連	<ul style="list-style-type: none"> <li>バッテリーメーカーによるアルミ両面蒸着膜の試用増加も、量産転換は依然鈍化。銅両面蒸着膜・リチウム膜等で中長期的な成長期待</li> </ul>	
コンポーネント・一般産業・ マテリアル・その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>半導体電子等における各種設備投資の活発化に伴い、安定基盤ビジネスとして堅調に推移</li> <li>先端デバイス等の研究開発活発化に伴う表面分析装置好調</li> </ul>	

Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

12

続きまして、カレンダーイヤ-25年~26年にかけての市場環境・投資動向です。

まず半導体についてですが、DRAMではHBM関連の投資が引き続き続いておりまして、特に韓国のトップメーカーとのビジネスがスタートできる見込みです。

NANDに関しては、ストレージ需要や生成AI関連の需要による投資が今後も継続すると見えています。

ロジックでは、次世代ノードに向けた投資が本格化し、中国向けを中心にMHM工程が展開される予定です。

次に各種電子デバイスですが、生成AI向けのWLPビジネスが引き続き続いており、PLPの開発投資も活発化していくことが期待されています。

また、ARやVR向けの中国のオプトデバイスへの投資も貢献してくる見込みです。パワーデバイスについては、中国の大手デバイスメーカーを中心に、8インチSiCの投資が回復していく見通しです。

ディスプレイ分野では、中国でのタブレット向けOLEDの実現に向けて、設備の追加や改造案件があり、これが持続的に貢献していくと考えています。

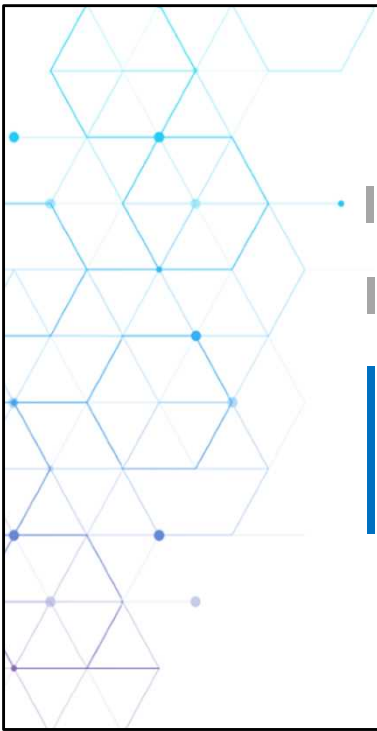
バッテリーに関しては、バッテリーメーカーによるアルミ両面蒸着膜の試用が増えていますが、量産への転換はまだ鈍化しています。

今後は銅両面蒸着膜やリチウム膜などで中長期的な成長を期待しています。

最後にコンポーネントなどですが、半導体電子分野での各種設備投資が活発化していることから、安定した基盤ビジネスとして堅調に推移しています。

また、先端デバイスの研究開発が活発になる中で、表面分析装置も好調に推移する見込みです。

ここまで、25年6月期の業績及び26年6月期の見通しについての説明となります。



• | 2025年6月期 業績概要

• | 2026年6月期 業績予想

**新中長期経営計画～ Value Up Plan～**

• 事業改革

• 成長戦略


• 生産改革

• 資本政策

## ■ 半導体電子中心の事業ポートフォリオの選択と集中

## 成長戦略

- 半導体電子への注力加速
- 事業間シナジーを活用した新たな半導体電子関連ビジネスの創出
- M&A等を活用したビジネス拡大

約**1,100**億円UP
 31/6期までの  
連結売上高増加額

&lt;31/6期 中長期財務目標&gt;

営業利益 **790**億円営業利益率 **22%**


## 事業改革（2年間で完遂）

- 低採算事業等の縮小撤退
- グループ会社・生産拠点の再構築とスリム化
- 人件費・販管費等の適正化による固定費削減

**5.5% UP**
 28/6期までの  
営業利益率改善

## 生産改革

- 生産拠点の生産効率UP
- モジュラーデザインによる収益性改善

**12% UP**
 31/6期までの  
対象装置事業における  
営業利益率改善

Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

14

前回の3Q説明会でもお話ししましたが、今期から31年6月期までの6年間、新しい中長期経営計画、「バリューアッププラン」をスタートさせます。経営資源の最適化を進めて、特に半導体・電子分野中心の事業ポートフォリオへの見直しを加速し、高い成長と収益体制の実現による企業価値の向上を目指していきます。

過去数年間は、5つの成長ドライバーを設定して事業拡大と収益性の改善に一定の成果を上げてきましたが、これまでの中期経営計画の延長線上では成長に限界があると判断し、抜本的な改革が必要だと考えました。

今回の成長戦略のポイントは、改革を土台にし、半導体や電子分野に経営資源を大胆に集中させ、事業間のシナジーを最大限に活かしながら、新しいビジネスを生み出していくことにあります。

これによって、2031年6月期までに売上高を約1,100億円増やし、連結全体の目標として営業利益790億円、営業利益率22%の達成を目指していきます。

新しい計画の最初のステップは「事業改革」です。低採算の事業を徹底的に見直して、生産拠点の再構築や固定費の削減を、2年間でしっかりとやり切ります。

その結果、2028年6月期までに、2025年6月期と比べて営業利益率を5.5ポイント改善することを目標にしています。

次に「生産改革」ですが、こちらはモジュラーデザインの徹底推進によって生産効率を大きく向上させ、収益基盤を強化していきます。対象となる装置事業では、2025年6月期と比べて営業利益率を12ポイント改善する計画です。

このように、必ずや更なる成長を実現し、企業価値の飛躍的な向上を図ってまいります。

項目	2025/6期 通期実績	2028/6期 中間目標	2031/6期 目標
<b>売上高</b> (CAGR)	2,512億円	<b>2,600億円</b> (事業改革による縮小撤退考慮後)	<b>3,600億円</b> (CAGR 12%) *
半導体電子関連ビジネス**			(CAGR 17%)
<b>半導体電子関連ビジネス 売上高構成比</b>	36%	<b>45%</b>	<b>60%以上</b>
<b>営業利益</b>	265億円	<b>390億円</b>	<b>790億円</b>
<b>営業利益率</b>	10.6%	<b>15%</b>	<b>22%</b>
半導体電子関連ビジネス	11.6%	19%	25%
<b>ROE</b>	7.5%	<b>10%</b>	<b>16%</b>

\* 事業改革後の想定売上高をベースに計算  
 \*\* 管理会計に基づく数値 半導体電子事業及び関連事業

Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

15

バリューアッププランの中長期財務目標です。

中間点となる28年6月期についてですが、売上高は事業改革の影響で、低採算事業の縮小や撤退があるため、一時的に減少する部分もあります。

そのため、25年6月期と比べると成長は一定程度にとどまる見込みです。

その一方で、事業改革の効果や半導体・電子関連ビジネスの構成比がさらに高まることで、営業利益率は15%を目標にしており、大きな改善を見込んでいます。

そして、最終目標となる31年6月期では、売上高3,600億円、営業利益790億円を掲げています。事業ポートフォリオの選択と集中を進めて、収益性の高い半導体・電子関連ビジネスの売上構成比を60%以上に引き上げます。

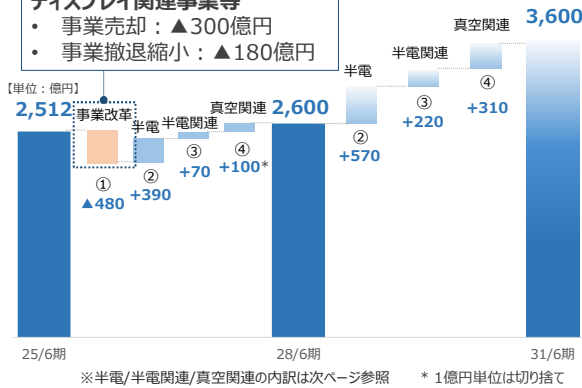
これにより事業ミックスが改善し、収益性が大幅に向上することで、営業利益率22%、ROE16%を目指してまいります。

» 28/6期までに事業改革による売上高減少を上回る半導体電子事業等の成長を目指し、営業利益率の着実な改善を実現

売上高増減要因

- ① 低採算事業等の縮小撤退等による売上高減少
- ② 半導体電子ビジネスの売上高増加
- ③ 半導体電子関連ビジネスの売上高増加
- ④ 真空関連ビジネスの売上高増加

事業改革による売上高減少  
ディスプレイ関連事業等  
・ 事業売却：▲300億円  
・ 事業撤退縮小：▲180億円

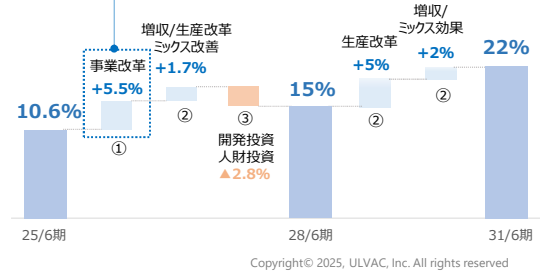


営業利益率増減要因

- ① 事業改革による利益率改善
- ② 生産改革・ミックス改善・増収による営業利益増加
- ③ 28/6期以降の成長に向けた製品開発投資・人財投資等

事業改革による利益率改善

- ・ 低採算事業等の縮小撤退
- ・ グループ会社・生産拠点の再構築とスリム化
- ・ 人件費・販管費等の適正化による固定費削減



目標達成に向けた道筋をご説明します。

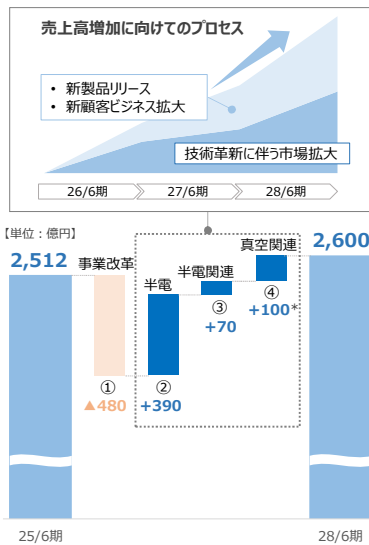
右側のウォーターフォールチャートは、28年6月期および31年6月期の売上高増減要因を表しています。

先程も述べた通り、28年6月期にかけて事業改革による売上高の減少を480億円見込んでいます。一方、その間に売上高の減少を上回る成長を半導体電子事業中心に計画しており、28年6月期の売上高は2,600億円を目指してまいります。こちらは次のスライドで詳しくご説明します。

右側のウォーターフォールチャートは、28年6月期および31年6月期の営業利益率の増減要因を表しています。事業改革により5.5pt、増収・生産改革・ミックス効果により、1.7ptの改善を図ってまいります。成長に向けた製品開発投資・人財投資を緩めずに実施してまいりますので、28年6月期の営業利益率の着地は15%と見込んでいます。

28年6月期までに土台を築き上げ、31年6月期に飛躍的に利益率を伸ばしていきます。

» 既存ビジネスをベースに技術革新に伴う市場拡大と顧客技術ロードマップに連動した新製品リリースなどにより、事業改革に伴う売上高減少を上回る半導体電子事業等の成長を目指す



## ■ 28/6期にかけての売上高増加要因

② 半導体電子	+390億円
<ul style="list-style-type: none"> <li>メモリ</li> <li>ロジック</li> <li>パワーデバイス</li> <li>各種電子デバイス</li> </ul>	HBM関連投資活発化 + 新顧客・新工程参入 ハードマスク工程展開 + 金属膜工程参入 8inchSiC投資本格化 + GaN投資開始 パッケージングビジネス活況 + 新顧客・新工程参入
③ 半導体電子関連	+70億円
<ul style="list-style-type: none"> <li>表面分析装置</li> <li>マテリアル(半導体)</li> </ul>	分析装置シェア堅持 + 半導体検査装置ビジネス参入 半導体ビジネス活況 + 競争優位製品で拡大
④ 真空関連	+100億円*
<ul style="list-style-type: none"> <li>コンポーネント</li> <li>バッテリー等</li> <li>リークテスト</li> </ul>	半導体電子市場向け新製品リリースによるビジネス拡大 リチウム電池の安全性向上へ両面蒸着膜採用進展 データセンター向け冷却システム等、多用途展開拡大

\* 1億円単位は切り捨て

Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

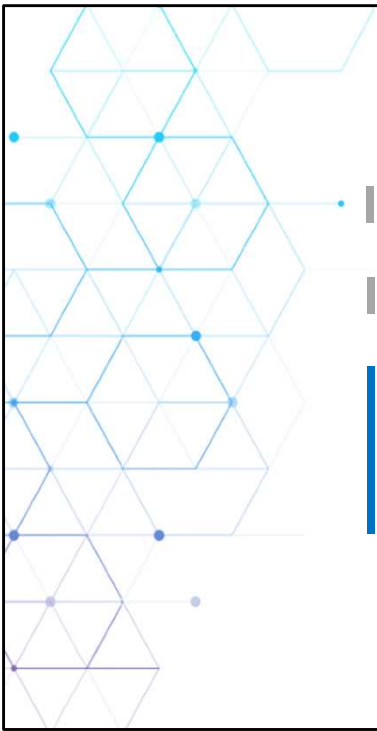
17

28年6月期にかけての売上高の増加要因についてご説明します。

左下のグラフ、①事業改革によって売上高の減少を480億円としておりますが、これまで培ってきた既存ビジネスをベースにして、技術革新に伴う市場拡大に加えて、顧客技術ロードマップに連動した新製品リリースなどによって、事業改革に伴う売上高の減少を上回る半導体電子事業中心に成長を目指してまいります。

その内訳については右側②③④に記載のとおり、主に半導体電子では、メモリ・ロジックのビジネス拡大、パワーデバイスの復調、また各種電子デバイスの中でもパッケージングビジネスの成長を期待しており、3年間で390億円増やしていく予定です。

その他、半導体電子関連ビジネスは表面分析装置などで70億円増加、コンポーネント、バッテリー、リークテスト装置などの真空関連ビジネスで100億円増加を目指しています。



• | 2025年6月期 業績概要

• | 2026年6月期 業績予想

### 新中長期経営計画～ Value Up Plan～

• 事業改革

• 成長戦略

• 生産改革

• 資本政策

**経営資源の最適化を断行**

- 低採算事業等の縮小撤退
- グループ会社・生産拠点の再構築とスリム化
- 人件費・販管費等の適正化による固定費削減

**27/6期までの2年間で経営資源の最適化施策を完遂  
28/6期初からの収益率寄与を想定**

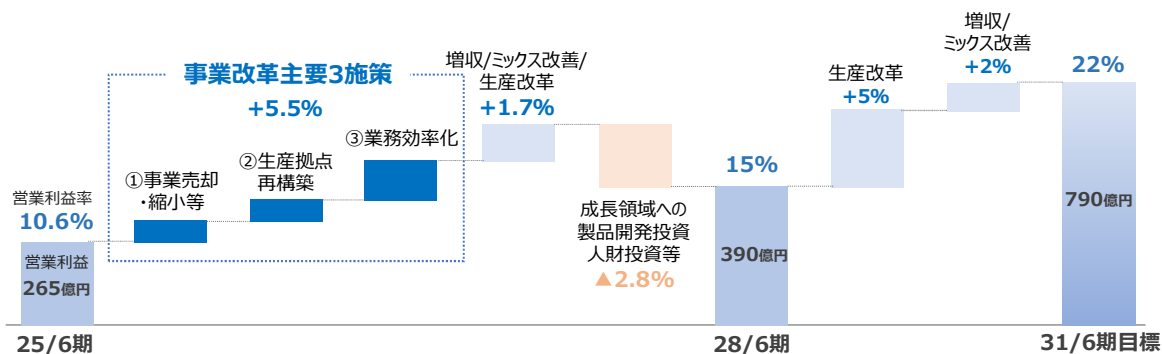
27年6月期までの2年間で「事業改革」期間と位置づけ、経営資源の最適化施策を完遂します。この期間で、筋肉質で強靱な経営基盤を構築するため、やりきる覚悟で改革を断行いたします。

この事業改革では、

- 低採算事業等の縮小撤退
- グループ会社・生産拠点の再構築とスリム化
- 人件費・販管費等の適正化による固定費削減を実行してまいります。

これらの施策を通じて、低採算事業の縮小撤退を含む大胆な改革を進め、28年6月期の期初からの収益率への寄与を実現してまいります。

## 目標達成に向けた道筋（営業利益率増減要因）



	主要3施策	内容
事業改革	① 事業売却・縮小等	持分譲渡による非連結化を含み6事業の売却・縮小等
	② 生産拠点再構築	工場縮小（1拠点）、工場内一部事業の生産縮小後、他事業転用（2拠点）
	③ 業務効率化	業務・機能の統合等による業務効率化
生産改革		MD化による調達・部品共通化による変動費削減、設計・製造効率向上と拠点集約による固定費削減
成長領域への投資		成長領域（半導体電子等）への製品開発投資・人財投資等

Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

20

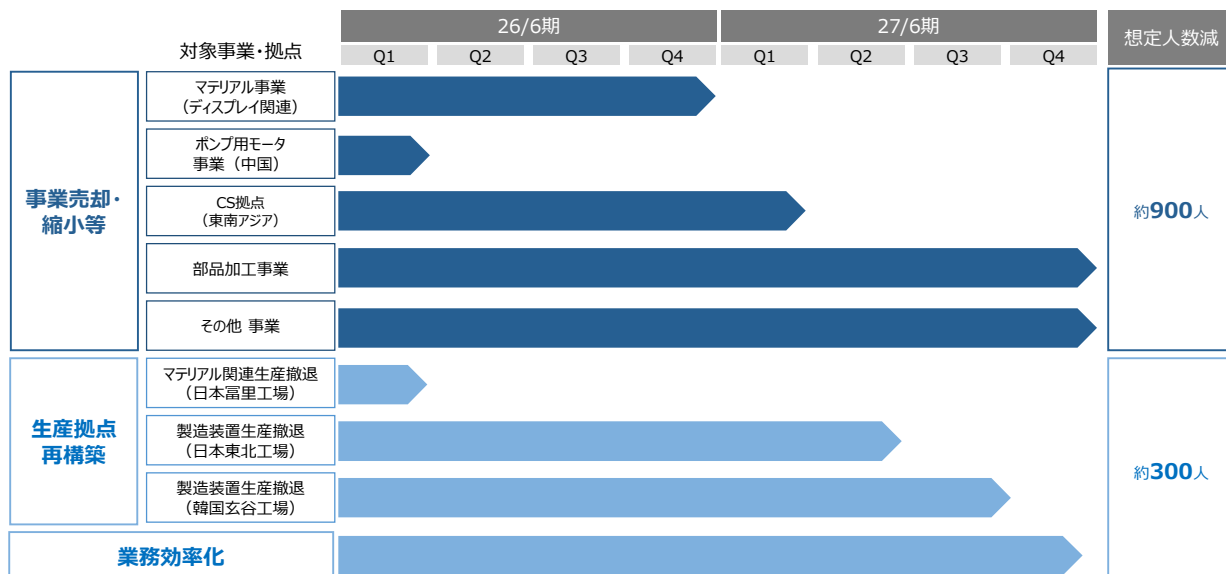
営業利益率の目標達成に向けて、青枠で囲っている事業改革を主要3施策に分けてご説明します。

一つ目は、事業売却・縮小等です。持分譲渡による非連結化を含み、6事業の売却・縮小等を実施してまいります。

二つ目は、生産拠点の再構築です。1拠点は工場を縮小、2拠点は工場内の一部事業の生産縮小後に他事業への転用を図ってまいります。

三つ目は、業務効率化です。業務・機能の統合などによって業務効率化を図ってまいります。

これらの改革を断行することで、5.5ptの利益率ベース改善を見込んでおります。



※アルバック・テクノ株式会社、タイゴールド株式会社は2025年7月1日に合併済み

Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

21

事業改革の主な施策のロードマップです。

矢印は各施策の完了時期を示しており、矢印がQ1で止まっている案件は既に完了しており、結果が出ているものもございます。

また、ディスプレイ関連のマテリアル事業およびポンプ用モーター事業については、本日個別に開示しており、参考資料に添付しておりますので、後ほどご覧ください。

このように、事業改革の各案件ごとに進捗状況を適宜公表してまいります。

» 経営資源の最適化等により、28年6期における営業利益の改善効果として120億円（2025年6月期比）を見込む



その他PL影響  
 一時的な費用は特別損益として計上されるものの、事業売却益等もあり、影響は限定的

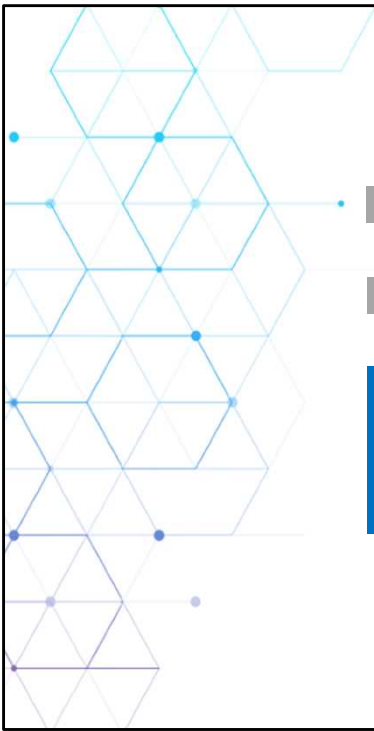
事業改革によるインパクトについてです。

これらの取り組みを完遂することで、連結全体の人員は約6,200人から5,000人へと1,200人の削減を見込んでおります。また、連結子会社数も29社から21社へと8社減少いたします。

その結果、2028年6月期には営業利益が2025年6月期比で120億円改善する見込みです。

なお、その他の損益計上については、一時的な費用は特別損益として計上されますが、事業売却益も見込まれるため、全体への影響は限定的と考えております。

このように、事業改革を2年間でやり切り、収益率の向上を図ってまいります。



• | 2025年6月期 業績概要

• | 2026年6月期 業績予想

**新中長期経営計画～ Value Up Plan～**

• 事業改革

• 成長戦略

• **生産改革**

• 資本政策

**モジュラーデザイン（MD）推進強化**

- MD化によるVolume調達及び部品共通化⇒ 変動費削減
- MD化による設計・製造効率の向上とリードタイム短縮、製造拠点の集約による生産効率向上⇒ 固定費削減

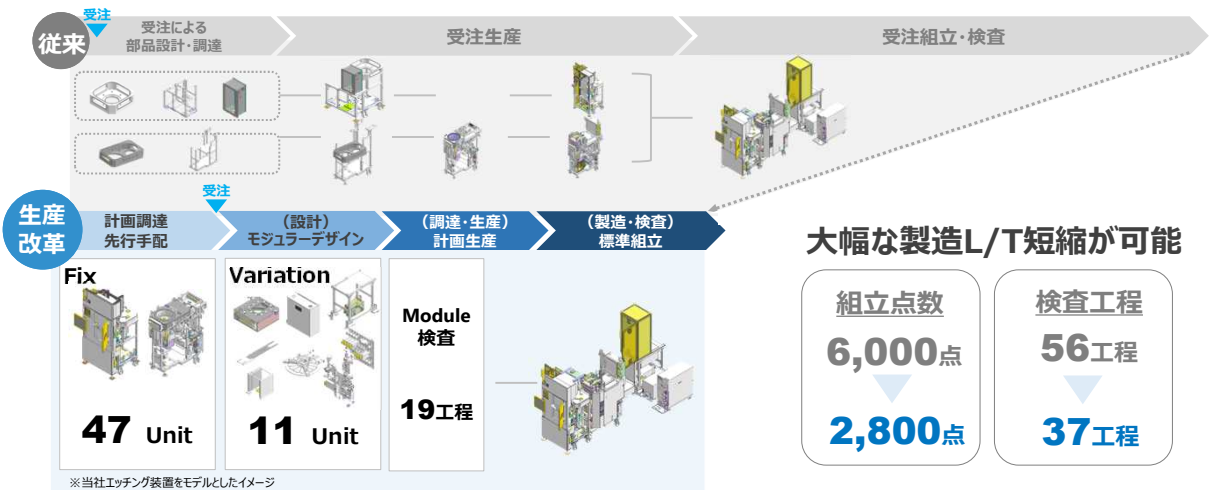
**生産性改善による利益最大化の実現**

モジュラーデザインを推進強化することで、生産性改善による利益最大化の実現を目指します。

1点目、モジュラーデザイン化による調達のボリュームを上げ、部品の共通化を図ることで変動費を削減します。

2点目、モジュラーデザイン化による設計・製造効率の向上とリードタイム短縮、製造拠点の集約による生産効率を向上することで、固定費の削減を図ってまいります。

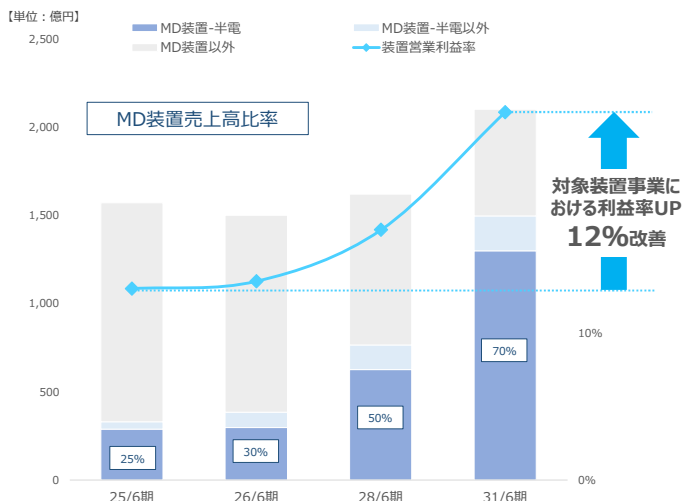
» 従来の受注後に製造プロセスを開始する方式に対し、モジューデザインの推進により先行手配・計画生産等を実現。効率的な生産体制の構築により、大幅な製造リードタイム（L/T）の短縮が可能



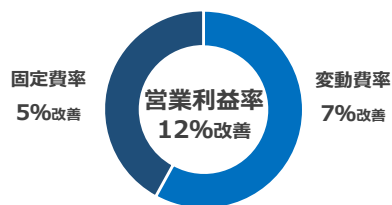
モジューデザインの概要についてです。

従来の受注後に製造プロセスを開始する方式に対し、モジューデザインの推進により先行手配・計画生産等を実現でき、効率的な生産体制の構築により、大幅な製造リードタイムの短縮が可能となります。

» 半導体電子中心のモジュラーデザイン装置割合を高め顧客ニーズに迅速に対応し、製造拠点集約を進めることで収益性改善を実現



31/6期まで生産改革効果（対象装置事業）



固定費率  
5%改善

変動費率  
7%改善

調達L/T短縮、変動費(率)圧縮

- 部品共通化と計画的まとめ発注で部品価格Down
- 組立予定に合わせた部品調達

設計工数圧縮、L/T短縮

- 図面を変えない組合せ（互換性のある設計）で顧客仕様を実現

製造L/T短縮、出荷台数Up、工数削減

- 標準組立と計画生産で生産最適化

Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

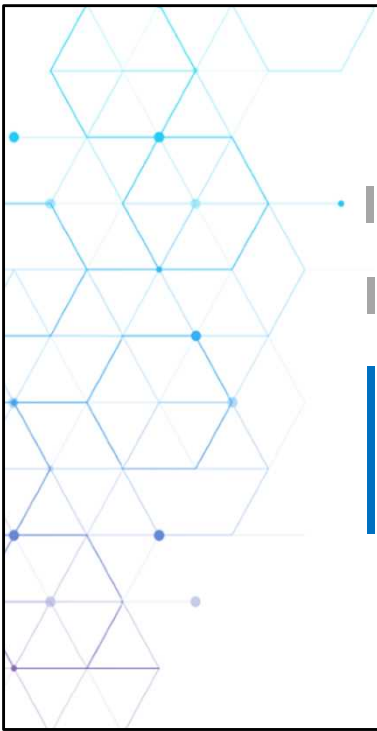
26

生産改革における収益性改善効果についてです。

モジュラーデザイン装置の売上高比率を高めることで、対象装置事業である半導体、電子、VMS事業における営業利益率を31年6月期までに12%改善してまいります。

営業利益率12%改善の内、部品共通化と計画的まとめ発注による部品コストダウンや、組み立て予定に合わせた部品調達により、変動費率を7%改善、設計工数圧縮、製造リードタイム短縮などにより人件費を増やさず効率的な生産体制を構築することで、固定費率を5%改善してまいります。

これらの取り組みにより、事業改革と合わせて、利益率のベースをしっかりと改善していきます。



• | 2025年6月期 業績概要

• | 2026年6月期 業績予想

### 新中長期経営計画～ Value Up Plan～

• 事業改革

• **成長戦略**

• 生産改革

• 資本政策

**半導体電子中心に更なる成長**

- 事業間シナジーを活用した新たな半導体電子関連ビジネスの創出
- 半導体電子事業の成長加速
- AI関連ビジネス拡大の取り組み
- M&Aを活用したビジネスの拡大

**半導体電子を中心とした事業ポートフォリオへの変革を通じて  
事業基盤を強化し、高成長/高収益性を目指す**

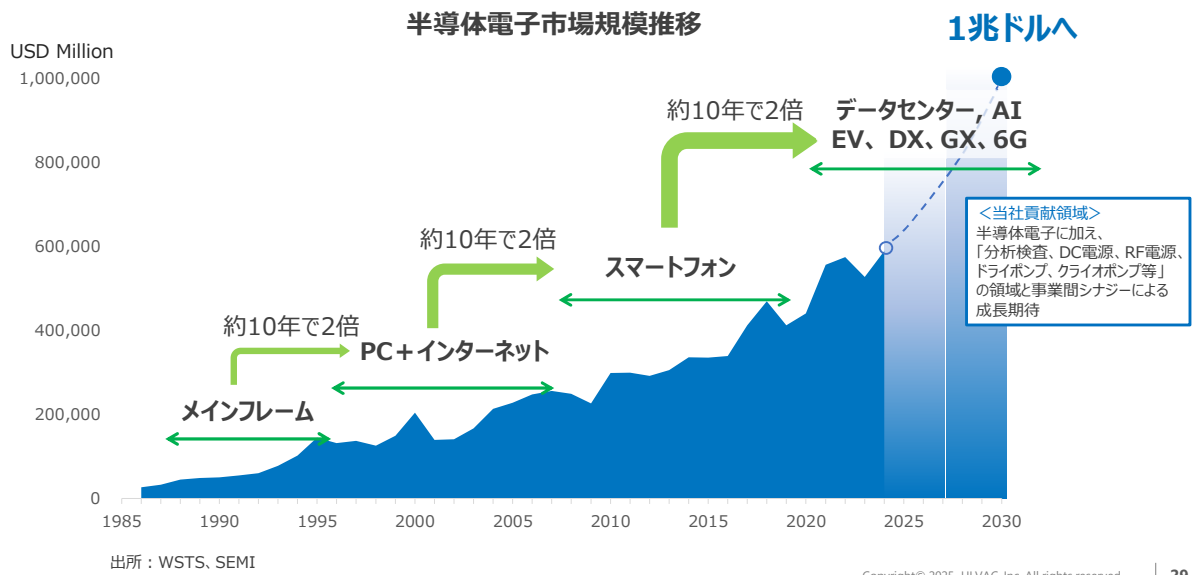
これまでご説明しました「事業改革」と「生産改革」を基盤として、次のステップである「成長戦略」を推進してまいります。

この戦略では、半導体・電子分野を中心にさらなる成長を目指し、既存事業間のシナジーを最大限に活用することで、新たな半導体・電子関連ビジネスを創出していきます。

具体的には、半導体・電子事業への注力をさらに強化し、成長を加速させるとともに、その中でも特に今後成長が期待されるAI関連ビジネスを中心に、多くの成長機会を捉え、当社の技術力と事業基盤を活かして事業を拡大してまいります。

また、M&Aを活用したビジネスの拡大も視野に入れて取り組んでまいります。

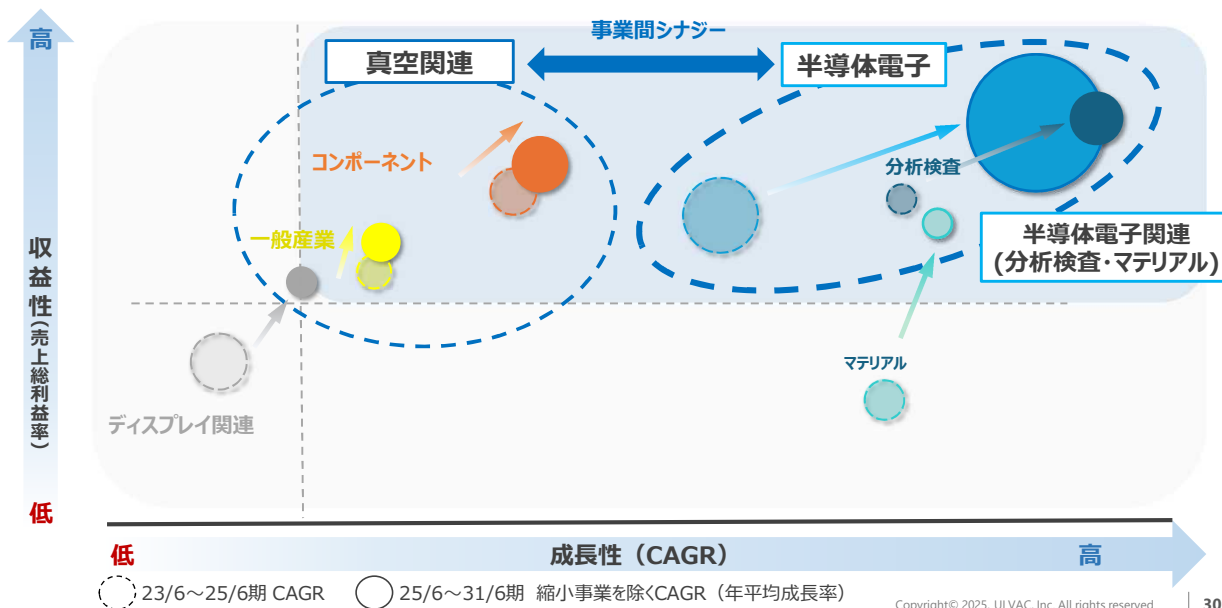
» 半導体電子市場は2030年に1兆ドルへ成長



主戦場となる半導体電子市場の予測です。

半導体・電子市場は、今後さらなる拡大が期待されており、2030年には市場規模が1兆ドルに達すると予測されており、しっかりとビジネスチャンスをつかんでいきたいと思ひます。

バブルの大きさ：売上高、矢印の先のバブルが将来の姿を示す、将来のバブルは31/6期時点の姿



バリューアッププランで描く、事業ポートフォリオ戦略のイメージです。

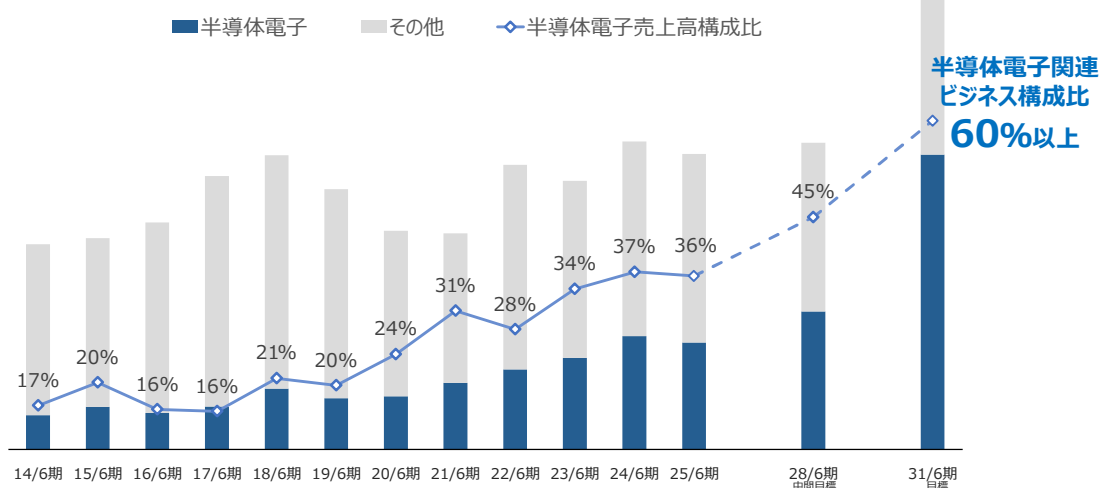
ご覧の通り、右側の半導体電子関連と左側の真空関連事業の二つの大きなくりに、事業ポートフォリオを集約していきます。

成長性と収益性が見込める右上の水色枠にプロットされる事業に注力していくことになります。

半導体電子市場が成長する中、半導体電子関連事業に経営資源を集中させ、事業ポートフォリオを変革していきます。

また、真空関連事業につきましても、得意分野であるポンプ、電源などのコンポーネント分野など、半導体電子事業との事業間シナジーによって、多くのビジネスチャンスが生まれると考えています。

» バリューアッププランにより獲得する筋肉質な体制を基に、半導体電子への注力加速・事業間シナジーを活用した新たな半導体電子関連ビジネスの創出により、高成長/高収益性を実現



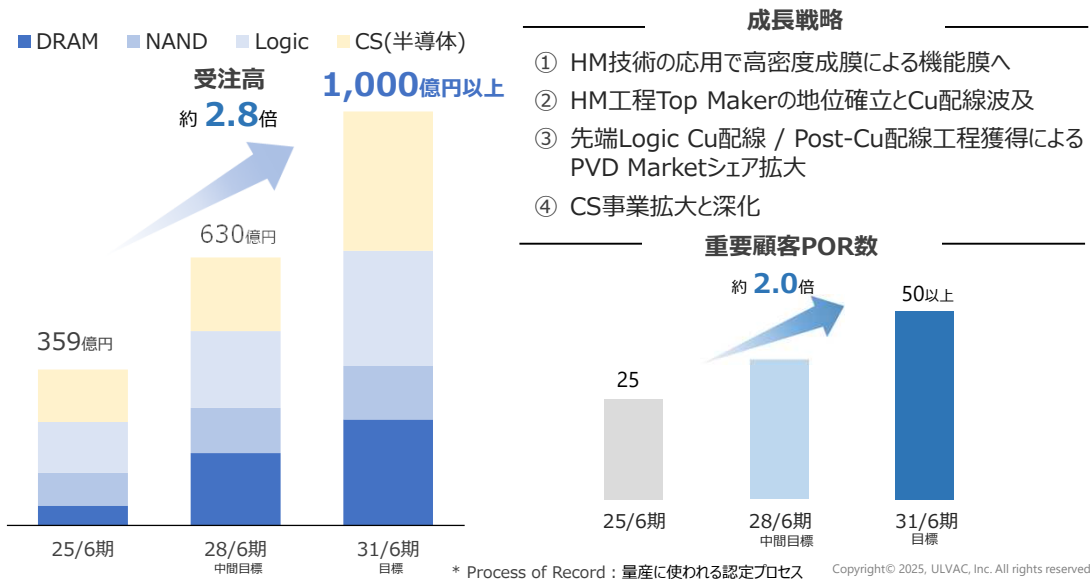
Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

31

このグラフは、半導体電子構成比の経年の推移を示しております。

半導体電子へ事業ポートフォリオをシフトさせる中、半導体電子の構成比を現状の36%から、28年6月期には45%へ、そして31年6月期には60%以上とすることで、高成長、高収益性を実現してまいります。

» 実績のあるハードマスク技術や金属成膜技術を基盤に、重要顧客のPOR\*数を増加し、新工程の獲得によるシェア拡大を図り、31/6期：受注1,000億円以上を目指す

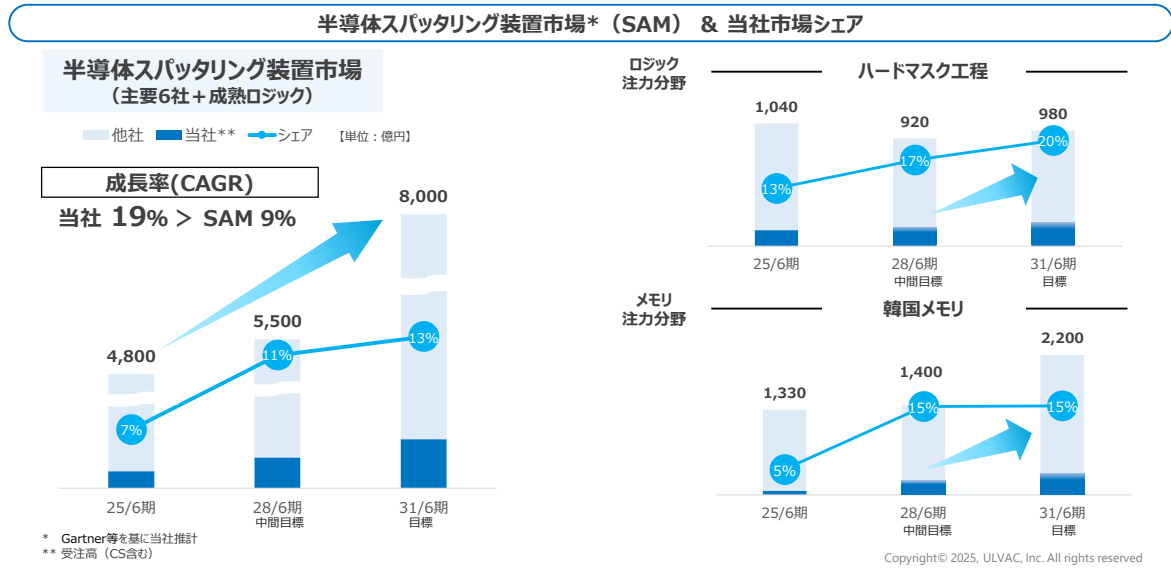


ここからは事業別の成長戦略をご説明いたします。

まず、半導体分野における具体的な成長シナリオです。

実績のあるハードマスク技術や金属成膜技術を基盤に重要顧客のPOR数を増やし、新工程の獲得によるシェアを図り、31年6月期には受注高1,000億円以上を目指します。

» 半導体スパッタリング市場の成長率を上回る成長実現に向けて、ロジック分野ではハードマスク技術で新工程を開拓し、メモリ分野では韓国トップメーカーとの共同開発加速でシェア拡大



半導体市場の規模と当社ポジションについてです。

左側グラフをご覧ください、半導体スパッタリング市場は今後も成長が続き、31年6月期までのCAGRが9%と見込まれる中、当社では、シェアを拡大することで、市場成長を上回るCAGR19%で成長をしていきたいと考えています。

どのようにしてシェアを伸ばしていくかという点、右側グラフの通り、ロジック分野では、ハードマスク技術を中心として新工程を開拓してシェアを伸ばすこと、メモリ分野では韓国トップメーカーとの共同開発を加速することでシェアを伸ばしていくことで、スパッタリング市場におけるシェア拡大を図ってまいります。



**中長期目標**

**ハードマスクPVD+金属配線工程奪取でシェア確立**

- 5ナノ、3ナノのデファクトスタンダードであるメタル・ハードマスク技術を軸に、ハードマスク用途と応用技術プロセスにてシェア確立
- PVDが最も多く使われている金属配線工程の参入・拡大を目指す

受注高 約 **2.4** 倍

(億円)

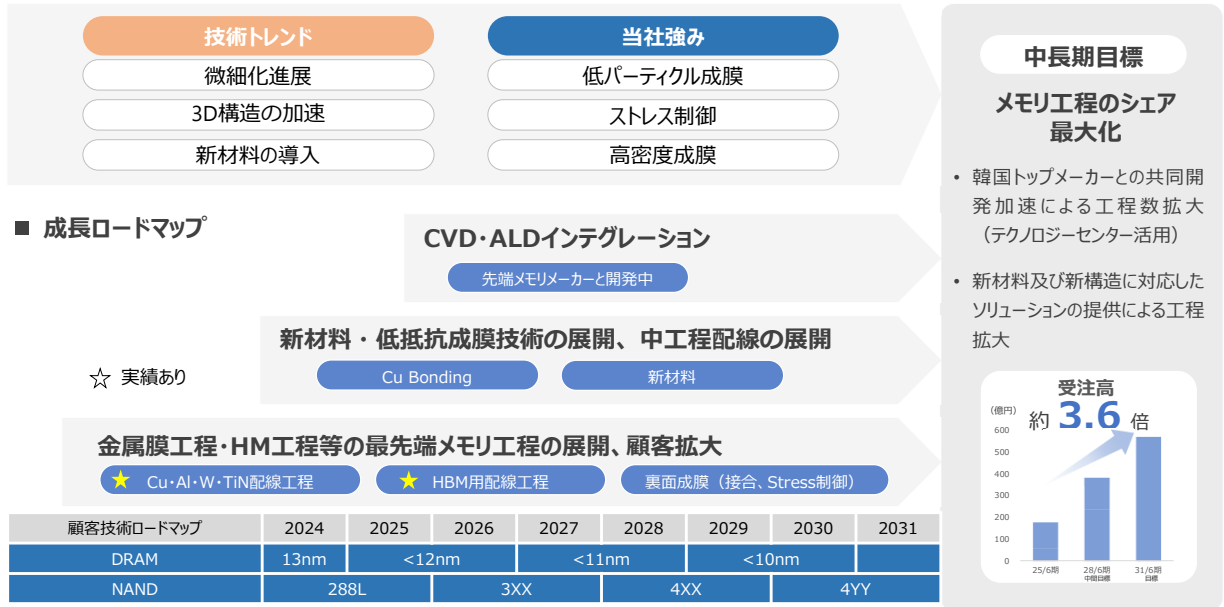
期	受注高 (億円)
25/6期	~150
28/6期 中期目標	~250
31/6期 目標	~400

Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

34

続いて、ロジックの具体的な成長ロードマップです。

ノードが進展していく中、ストレス制御・低パーティクル成膜を強みとしたハードマスク技術を展開し、シェアを確立した上で、PVDが最も多く使われている金属配線工程にも参入し、事業の拡大を図ることで、さらにシェアを伸ばしていく方針です。



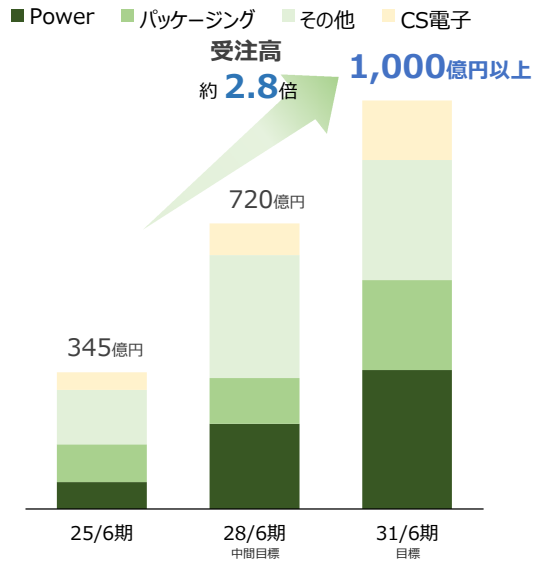
Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

35

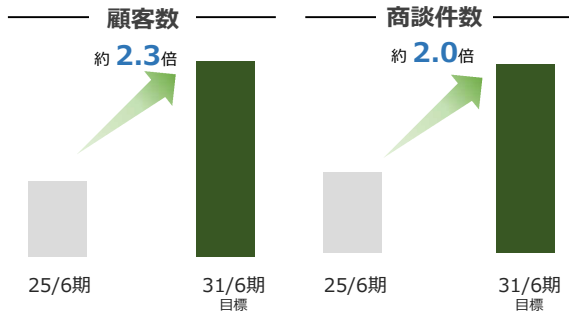
続いて、メモリの具体的な成長ロードマップです。

既に金属膜工程の実績を有しているため、さらなる工程の拡充を目指します。昨年竣工した韓国テクノロジーセンターを最大限に活用し、新材料や新構造に対応したソリューションを、韓国トップメーカーとの共同開発により一層加速させて、工程数の拡大を図ってまいります。

▶ パッケージングビジネスの活発化、パワーデバイス投資の回復等で1,000億円以上のビジネス規模へと拡大、更なる成長を目指す



- 成長戦略**
- ① SiC向けスパッタ・イオン注入に加え、GaN量産対応による適応拡大
  - ② 先端パッケージングの投資拡大・新工程獲得
  - ③ 通信機器の小型化に貢献するTFLN（薄膜リチウムニオブ酸）エッチング量産対応による光電融合ビジネス展開
  - ④ CS事業拡大と深化



Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

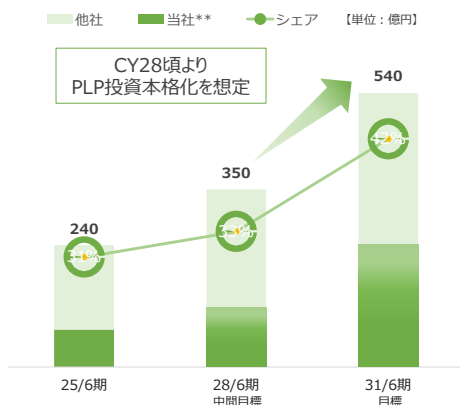
36

次に、電子デバイス分野における具体的な成長シナリオについてご説明いたします。

パッケージングビジネスの活発化、パワーデバイス投資の回復等で、こちらも、半導体分野と同様に1,000億円以上のビジネス規模へと拡大を目指してまいります。

- ▶ AIサーバー市場拡大に伴い、パッケージ市場は成長継続。先端パッケージ・アッシング分野中心にシェア拡大
- ▶ 電動化・省エネルギー化の進展により、パワーデバイス市場は拡大継続。革新する技術に応え、シェア拡大

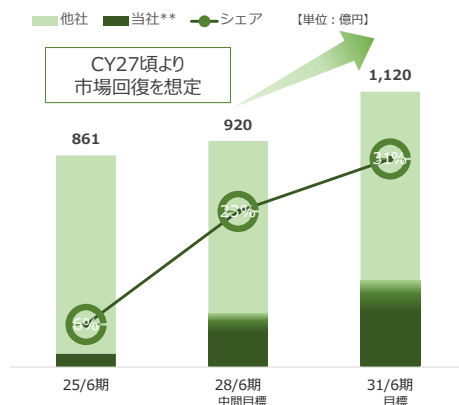
パッケージング・アッシング市場 SAM\* & 当社市場シェア



\* 当社調べによる推計  
\*\* 受注高(装置のみ、CS除く)

パワーデバイス・SiC、GaN市場 SAM\* & 当社市場シェア

(スパッタ・インプラ装置市場)



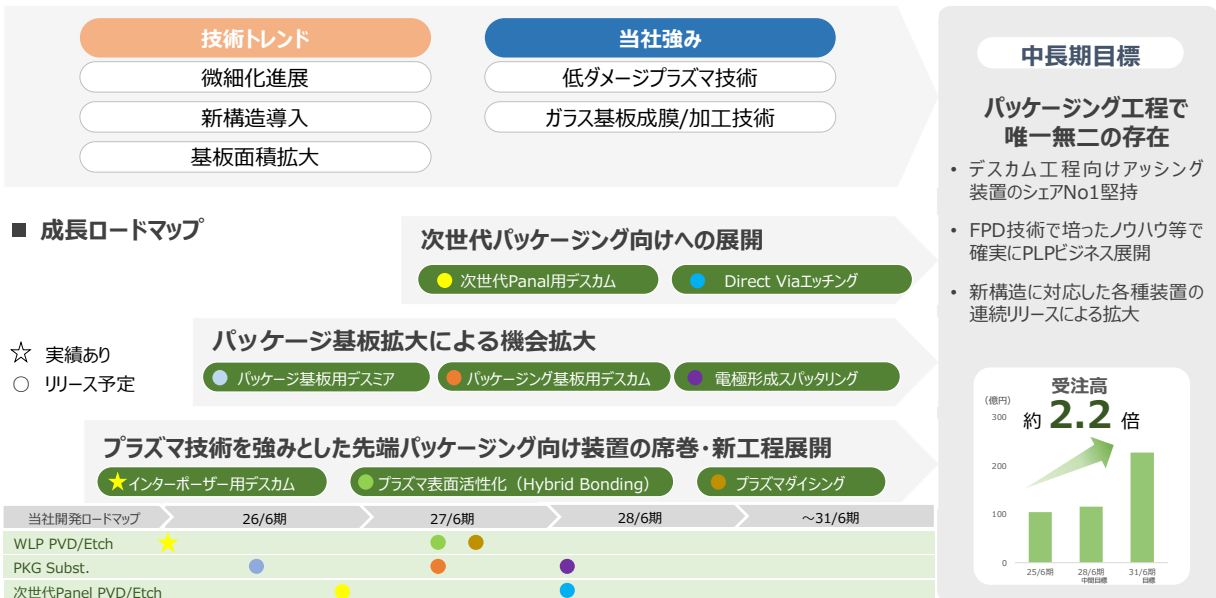
Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

電子デバイス市場の規模と当社ポジションについてです。

特に注力する分野としては、左側グラフのパッケージング分野、右側グラフのパワーデバイス分野となります。

パッケージング市場はAIサーバー市場拡大に伴い、成長継続が見込まれる中、アッシング装置などでシェアを拡大していきます。

パワーデバイス市場は電動化・省エネルギー化の進展により、市場は拡大すると見込んでおり、その中で革新する技術に応え、シェア拡大を目指します。

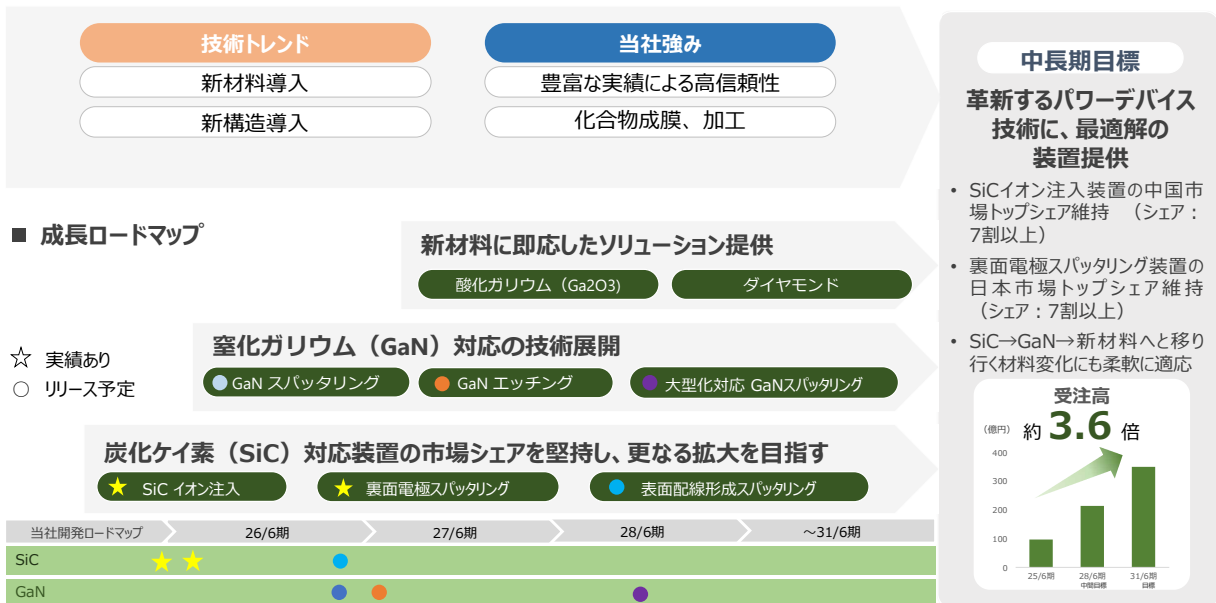


Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

38

パッケージングの具体的な成長ロードマップです。

先端インターポーザー用デスカム工程向けアッシング装置ではシェアNo1の実績をベースにし、パッケージ基板拡大に伴うビジネス機会をしっかりとつかむため、新しい装置を顧客技術ロードマップに合わせてリリースをしてパッケージング工程では唯一無二の存在としてポジションを構築していきます。



パワーデバイスの具体的な成長ロードマップです。

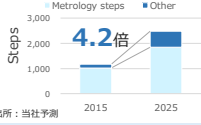
SiCに関連する工程においては、中国市場でイオン注入装置シェアNo.1のポジションを活かし、SiC市場の回復に伴い着実に成長を図ります。

加えて、次世代パワーデバイスである窒化ガリウム(GaN)対応の技術展開を推進し、革新的なパワーデバイス技術に最適な装置を提供することで、シェア拡大を目指します。

» 既存Lab型での経験と実績（シェアNo.1）を活かし、半導体電子との事業間シナジー等により、製造プロセス高度化による分析の重要度が高まるFab型へ“XPS”を本格投入し、検査装置市場におけるグローバルポジションの確立を目指す

## 市場環境

半導体製造工程は10年間で倍増し、中でも検査工程は4倍に



## 技術・要求トレンド

微細化進展に伴う工程数UP

歩留まり改善ニーズの高まり

品質管理の重要度向上

## 当社強み

表面分析専門メーカーの実績

R&D～サービス一貫体制

Software（Science）、Hardware（物理・光学設計、製造）の両面から価値を提供

～25/6期

### 研究開発向けXPS分析機器トップシェア

- 研究開発向けXPS分析機器の拡大
- 半導体量産ライン向けXPS検査装置のプロトタイプ開発



研究開発向けXPS分析機器

～27/6期

### 半導体量産ライン向けXPS検査装置の市場投入

- 研究開発向けXPS分析機器の高品質化
- 半導体量産ライン向けXPS検査装置の製品リリース

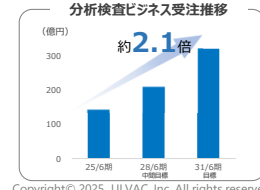


半導体生産ライン向けXPS検査装置イメージ

～31/6期

### グローバル展開による更なる拡大を目指す

- 研究開発向け分析機器のラインナップ強化
- 半導体量産ライン向けXPS検査装置の工程拡大
- 分析機器・検査装置で受注300億円規模の事業化



Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

半導体電子関連ビジネスの成長戦略です。

分析検査装置については、今後さらなる成長が期待されます。

これまで研究開発向けXPS分析装置でシェアNo.1を確保してきましたが、今後は半導体電子事業とのシナジーを活かし、半導体量産ライン向けXPS検査装置の市場投入を目指してまいります。

これらの取り組みを加速させることで、2031年6月期には300億円規模のビジネスへと成長させ、半導体電子関連ビジネスの新たな柱を構築していきます。

» 一般産業から半導体・電子部品、医療分野まで幅広い市場・用途に適応する充実した製品ラインナップを持つ強みを更に磨き、成長を目指す

真空ポンプ

多様な市場・アプリケーションに拡販



ドライポンプ

理化学・分析市場 国内トップシェアの小型ポンプに加え、半導体・電子市場向けポンプのラインアップ拡充によりシェア拡大

クライオポンプ/4K・希釈冷凍機

冷却技術で新市場開拓



低温機器 (クライオ)

小型省エネクライオポンプを半導体電子分野へ展開  
極低温技術を応用し、医療分野と量子コンピュータ市場へ挑戦

計測機器・成膜電源

アライアンスによるグローバル対応加速

デジタル制御電源の展開によるシェア拡大



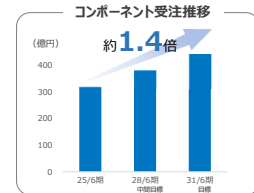
ヘリウムリークディテクター

EV関連ビジネスの拡大に加え、アライアンス強化を通じてグローバル半導体市場向け受注拡大



10kW Digital DC電源

デジタル制御技術をDC・RF・EB電源へ展開し、半導体・電子市場拡販  
省エネRF電源・省スペースEB電源等、新製品を市場投入



Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

半導体電子関連ビジネスに加えて、真空関連ビジネスとして位置付けているコンポーネントのビジネスについてです。

安定基盤ビジネスとして一般産業から半導体・電子部品、医療分野まで幅広い市場・用途に適応する充実した製品ラインナップを持つ強みを更に磨き、31年6月期には25年6月期比1.4倍の成長を目指していきます。

» 真空技術の可能性を最大化し、新たな価値創造で成長を目指す

熱処理炉

■ 一般産業用装置

レガシー装置の競争力向上



焼結処理・熱処理炉

高性能熱処理炉で高シェア堅持。FPD分野で培った大型量産装置のノウハウを活かし、装置の効率化と最適化を進め、競争力のあるソリューションを提供

Roll to Roll

■ ディスプレイ・エネルギー関連製造装置

幅広化対応による生産効率アップで市場奪取



両面蒸着巻取装置  
(1.6mフィルム幅対応モデル)

リチウム電池の安全性向上が求められている中、Al両面蒸着膜（下図①）への注目が高まる。フィルム幅（1.6m→2.5m）による生産性向上により面積あたりの生産コストを改善し、変化し続ける技術要求に的確に応えることで、No.1地位を堅持

リークテスト装置

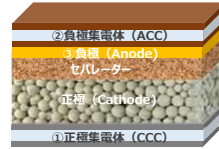
■ 一般産業用装置

アプリケーション展開によるビジネス拡大



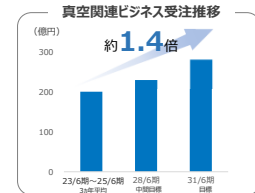
EVバッテリー用リークテスト装置

高性能リークテスト装置の高シェア堅持。空調・EV用途に加え、データセンター向け冷却システムなど幅広い用途への対応とカスタマイズ力に強み



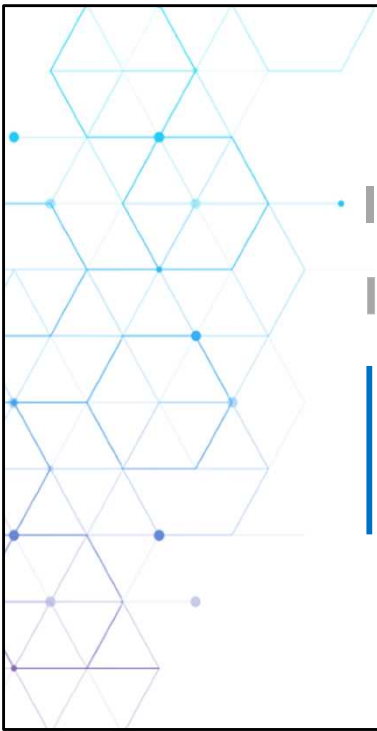
図：両面蒸着膜適用リチウム電池構造

ACC向けCu両面蒸着膜（②）、負極向けリチウム両面蒸着膜（③）は開発継続、早期実現を目指す



Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

その他の真空関連ビジネスとしては、「熱処理炉」、「リークテスト装置」、「Roll to Roll装置」などの装置に代表される分野において、真空技術の可能性を最大限に引き出し、新たな価値創造を通じて成長が期待される領域をさらに磨き上げてまいります。



• | 2025年6月期 業績概要

• | 2026年6月期 業績予想

**新中長期経営計画～ Value Up Plan～**

• 事業改革

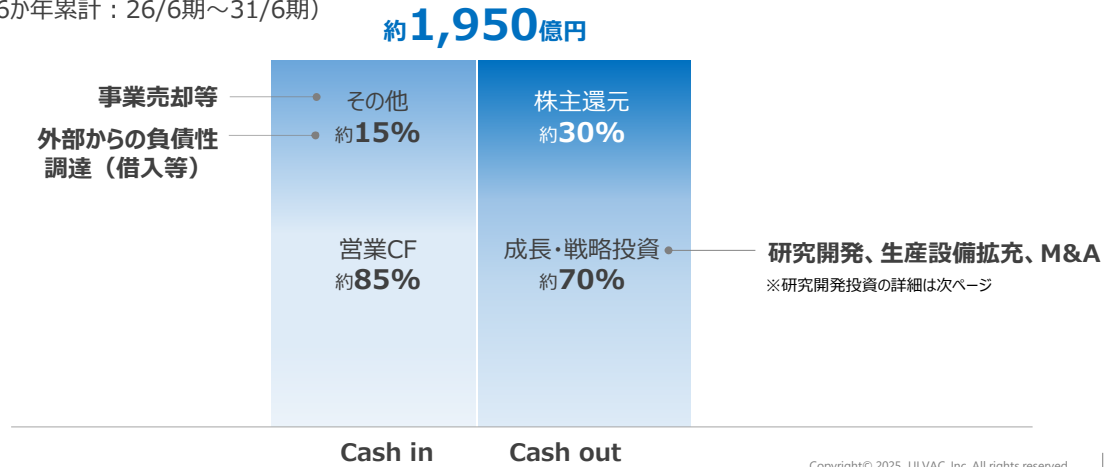
• 成長戦略

• 生産改革

• **資本政策**

- ▶ 半導体電子を中心に、成長のための開発投資強化やM&Aを実施
- ▶ 株主還元を最重要施策の一つと位置づけ、持続的な成長による長期的な増配に加え、将来的にはさらなる株主還元の拡充を目指す

■ キャピタルアロケーション  
(6か年累計：26/6期～31/6期)



Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

44

キャピタルアロケーションについてご説明します。

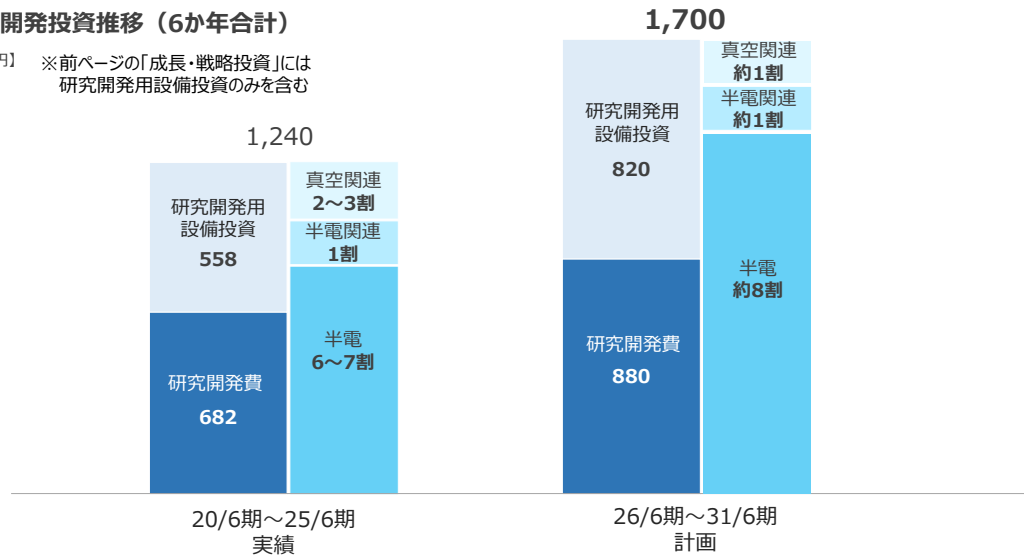
今後、6か年累計で約1,950億円のキャッシュインに対して株主還元には約30%、成長のための開発投資強化やM & Aに向けた投資は約70%を配分する予定です。

株主還元を最重要施策の一つと位置付け、持続的な成長による長期的な増配に加え、将来にはさらなる株主還元の拡充を目指してまいります。

» 半導体電子中心に研究開発強化 ⇒ さらなる成長に向けた研究開発投資継続

## ■ 研究開発投資推移（6か年合計）

【単位：億円】 ※前ページの「成長・戦略投資」には  
研究開発用設備投資のみを含む



Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

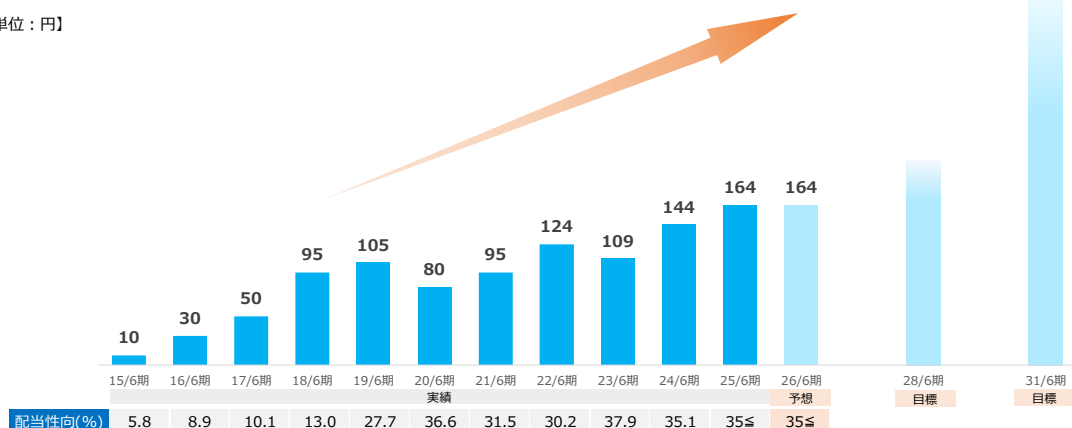
45

研究開発投資は過去6か年合計の1,240億円から、今後6か年合計で1,700億円と増額し、中でも半導体電子、半導体電子関連ビジネスへの投資をこれまでの7割~8割に対して、9割近くウェイトを高めることで、さらなる成長に向けた研究開発投資を継続してまいります。

- ≫ 引き続き、業績連動配当性向は**35%以上**を目途とし、株主還元重視による安定配当の観点から、26年6月期の配当は25年6月期と同額の1株当たり164円を予定
- ≫ 持続的な成長による**長期的な増配**に加え、将来的にはさらなる**株主還元の拡充**を目指す

## ■ 1株当たり配当金推移

【単位：円】



Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

46

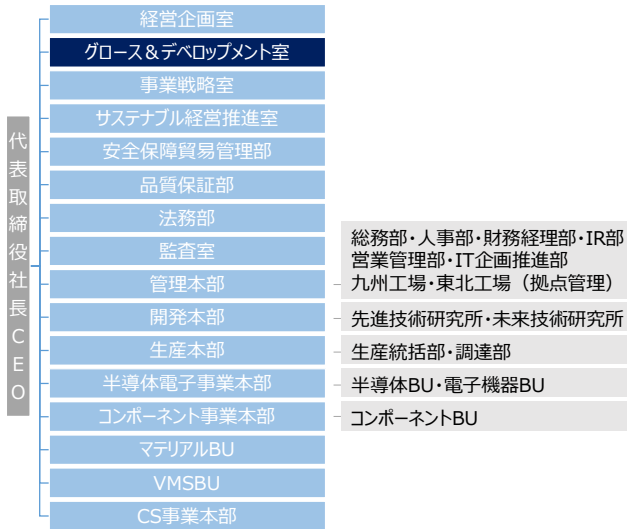
引き続き、業績連動配当性向を35%以上を目途とし、株主還元重視による安定配当の観点から、26年6月期の配当は25年6月期と同額の1株あたり164円を予定しています。

今後とも持続的な成長による長期的な増配に加え、将来的にはさらなる株主還元の拡充を目指します。

以上、バリューアッププランの説明とさせていただきます。

**組織変更：グロース&デベロップメント室新設**

バリューアッププランの実現サポート及びグローバル戦略策定・成長施策の実行を通じて、グループ全体のビジネス成長を加速



**富士裾野工場の使用電力：実質再生可能エネルギー100%実現**

2025年7月に半導体電子事業の主要拠点である富士裾野工場において、使用電力すべてを実質的に再生可能エネルギー由来の電力への切り替えを完了。

今後とも、太陽光発電設備の導入を計画的に進めるとともに各種再生エネ調達を推進していくことで、持続可能な社会の実現に貢献する。



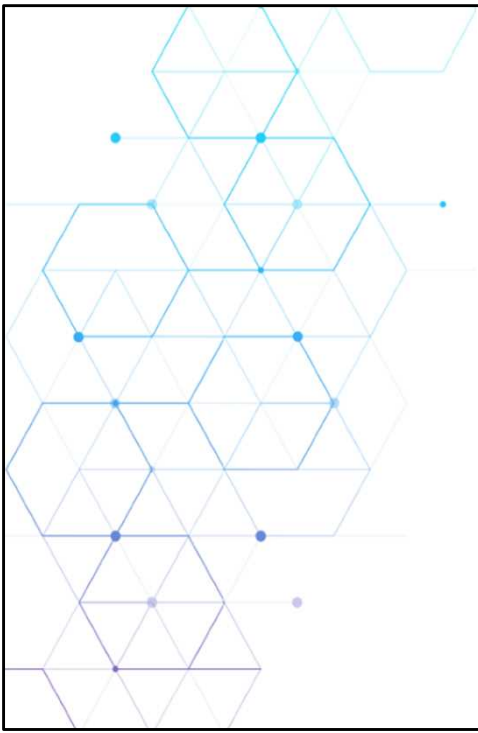
富士裾野工場

Copyright© 2025, ULVAC, Inc. All rights reserved

7月1日より、一部組織の変更を行い、新たにグロース&デベロップメント室を設置いたしました。

当室は、バリューアッププランの実現をサポートするとともに、欧米を含むグローバル戦略の策定および成長施策の実行を担っております。

これにより、グループ全体のビジネス成長を一層加速させてまいります。



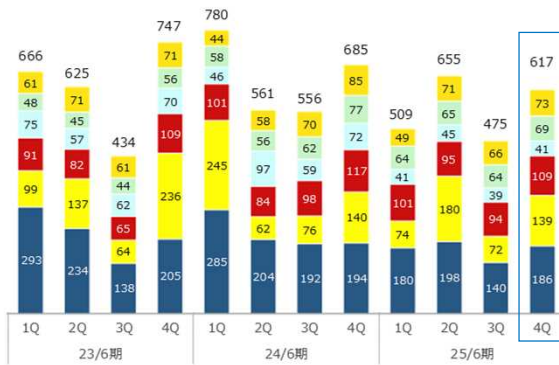
## 参考資料

【単位：億円】	2024/6期					2025/6期				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
受注高	780	561	556	685	2,582	509	655	475	617	2,256
売上高	550	652	650	759	2,611	610	739	529	635	2,512
売上総利益	153	201	220	233	807	191	238	176	193	799
率	27.7%	30.8%	33.8%	30.7%	30.9%	31.3%	32.2%	33.3%	30.5%	31.8%
販管費	124	126	119	139	509	134	142	122	136	533
営業利益	28	75	101	94	298	58	96	54	58	265
率	5.1%	11.5%	15.5%	12.3%	11.4%	9.4%	13.0%	10.2%	9.1%	10.6%
経常利益	29	81	95	93	298	69	92	61	65	286
率	5.3%	12.4%	14.6%	12.3%	11.4%	11.3%	12.4%	11.5%	10.2%	11.4%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	11	57	64	69	202	37	67	27	36	167
率	2.1%	8.8%	9.9%	9.1%	7.7%	6.1%	9.0%	5.1%	5.6%	6.6%

受注高

【単位：億円】

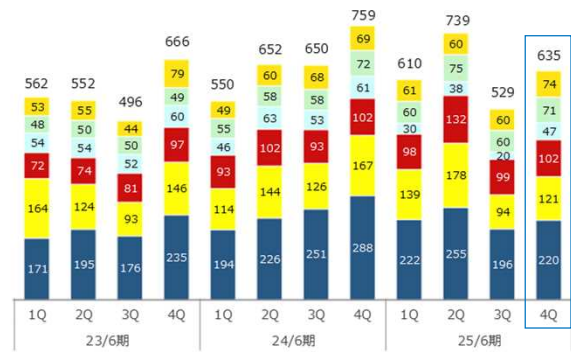
- 半導体及び電子部品製造装置
- コンポーネント
- マテリアル
- ディ스플레이・エネルギー関連製造装置
- 一般産業用装置
- その他



売上高

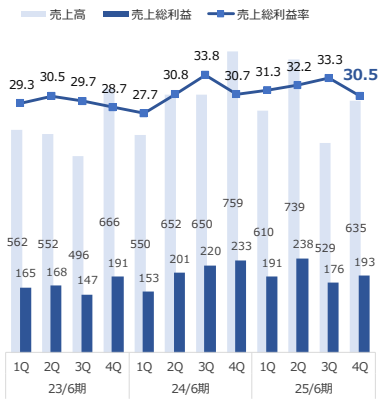
【単位：億円】

- 半導体及び電子部品製造装置
- コンポーネント
- マテリアル
- ディ스플레이・エネルギー関連製造装置
- 一般産業用装置
- その他



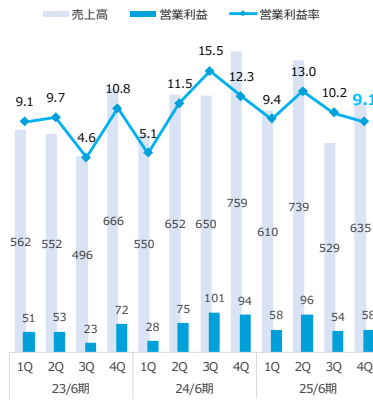
## 売上総利益率

【単位：億円、%】



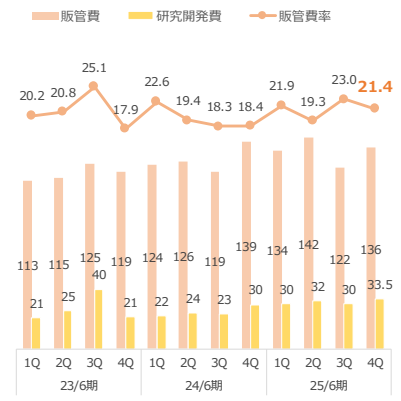
## 営業利益率

【単位：億円、%】



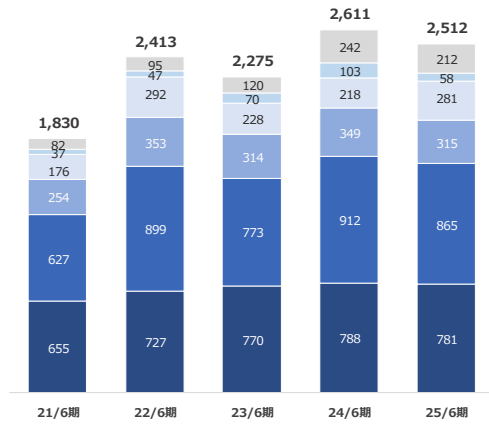
## 販管費率

【単位：億円、%】



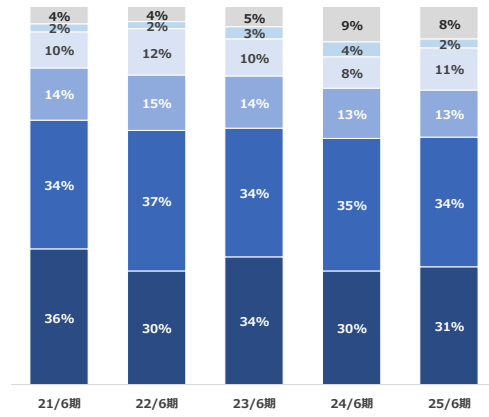
売上高 【単位：億円】

■ 日本 ■ 中国 ■ 韓国 ■ 台湾 ■ その他アジア ■ 欧米他

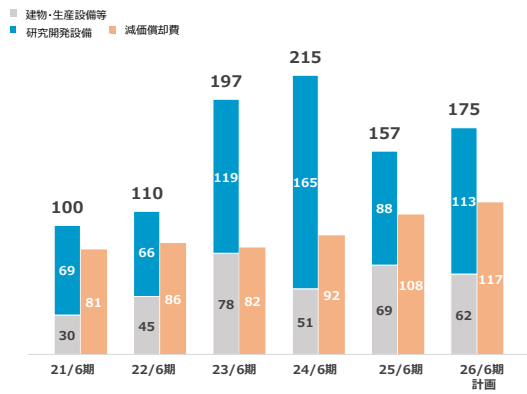


売上高比率

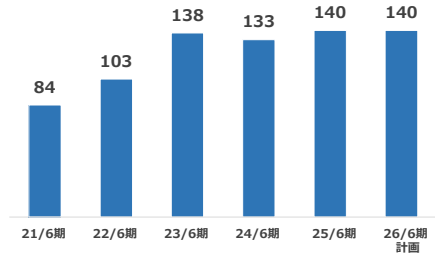
■ 日本 ■ 中国 ■ 韓国 ■ 台湾 ■ その他アジア ■ 欧米他



設備投資の推移・計画 [単位：億円]



研究開発費の推移・計画 [単位：億円]



※研究開発に関連する製造固定費含む

■ 品目別内訳割合

受注高	25/6期実績	26/6期計画
<b>半導体電子</b>	<b>704億円</b>	<b>910億円</b>
・メモリ	2割半ば	3割弱
・ロジック	2割半ば	2割弱
・電子部品	2割強	3割強
・パワー半導体	1割強	1割強
・実装	1割半ば	1割強
・その他	-	-
<b>ディスプレイ・エネルギー</b>	<b>465億円</b>	<b>400億円</b>
・LCD	3割弱	約2割
・OLED	7割弱	6割弱
・バッテリー	数%	約1割
・その他	数%	1割強

売上高	25/6期実績	26/6期計画
<b>半導体電子</b>	<b>893億円</b>	<b>1,005億円</b>
・メモリ	約2割	2割強
・ロジック	2割強	2割弱
・電子部品	2割半ば	3割半ば
・パワー半導体	2割半ば	1割強
・実装	約1割	約1割
・その他	-	-
<b>ディスプレイ・エネルギー</b>	<b>531億円</b>	<b>390億円</b>
・LCD	3割半ば	3割弱
・OLED	4割半ば	6割強
・バッテリー	1割半ば	1割弱
・その他	一桁半ば	数%

■ 2025年6月期営業利益率順位

順位	品目
1	一般産業
2	コンポーネント
3	半導体電子
4	その他
5	材料
6	ディスプレイ・エネルギー関連

全社平均利益率は  
4) その他と  
5) 材料との間

マテリアル事業（ディスプレイ関連）

ポンプ用モータ事業（中国）

ULVAC

2025年8月13日

各位

会社名 株式会社アルバック  
 代表者名 代表取締役社長 CEO 岩下 節生  
 (コード番号: 6728 東証プライム)  
 問合せ先 経営企画室 佐藤 吉仁  
 (TEL. 0467-89-2022)

KFMI との FPD ターゲット事業の統合に向けた協議について

株式会社アルバック(代表取締役社長 CEO 岩下 節生、以下アルバック)は、株式会社江豊電子材料股份有限公司(以下 KFMI)と連携し、両社のフラットパネルディスプレイ(以下 FPD)のターゲット事業統合に向けて協議しております。尚、この統合計画は現在調査・検討中であり、正式な契約はまだ締結されておりません。

○本件の背景  
 アルバックは真空技術のコアに半導体・電子部品・FPD 向け製造装置や真空機器、材料を開発、提供しておりますが、本日発表の計画の通り、事業構造の最適化を行い、半導体・電子事業へのシフトを進めてまいります。FPD の製造拠点は海外シフトが進んでいることもあり、今後 FPD ターゲット事業は KFMI と連携して展開することを検討してまいります。

以上

ULVAC

2025年8月13日

各位

会社名 株式会社アルバック  
 代表者名 代表取締役社長 CEO 岩下 節生  
 (コード番号: 6728 東証プライム)  
 問合せ先 管理本部 IR 部長 原田 大地  
 (TEL. 0467-89-2033)

愛発科天馬電機(靖江)有限公司の出資比率変更の件

首題の件、アルバックグループと江蘇上驥集団有限公司(以下、上驥)において持分譲渡契約を締結しましたので、お知らせいたします。

同社は、当社グループで生産している真空ポンプ用モーターを安定的に供給しており、コンポーネント事業を強化していく上で重要な合弁先として位置づけております。上驥に一部持分譲渡することで、現地での生産・開発体制を更に強化し事業の成長を目指します。

○持分比率

	現状	持分譲渡後
アルバックグループ	60%	40%
上驥	40%	60%

以上

- **PVD (Physical Vapor Deposition : 物理成膜)**  
薄膜形成をする成膜技術 (当社の場合は主にスパッタ)
- **MHM (Metal Hard Mask : メタル・ハード・マスク)**  
配線層形成を目的に、エッチング工程での加工用マスク膜 (当社はPVD : スパッタ膜)
- **FEOL (Front End of Line)**  
トランジスタやキャパシタ、抵抗などをシリコンウェハ上に形成する半導体製造プロセスの初期段階を指す
- **BEOL (Back End of Line)**  
FEOLで形成されたトランジスタなどのデバイスを接続するための配線や金属層を形成する半導体製造プロセスの後半工程を指す
- **GPU (Graphics Processing Unit : グラフィックス処理装置)**  
画像や映像の描画を高速に処理するために設計されたプロセッサ。AI推論では大量の加減乗除演算など、反復的な計算用に適する
- **HBM (High Bandwidth Memory : 高帯域幅メモリ)**  
複数のDRAMを垂直に積層し、シリコン貫通電極 (TSV) で接続することで、高速・高密度を実現した次世代メモリ技術
- **WLP (Wafer Level Package : ウェーハレベルパッケージ)**  
ウェーハ (半導体基板) の状態でパッケージング工程を行う技術で半導体パッケージング技術の一つ
- **PLP (Panel Level Package : パネルレベルパッケージ)**  
従来のウェーハレベルパッケージ (WLP) に代わり、四角いパネル状の基板を用いてパッケージングを行う半導体パッケージング技術の一つ  
パネルに多数の半導体チップを基板全体に配置して一括してパッケージングする技術
- **POR (Process of Record)**  
量産に使われる認定プロセス
- **HM (Hard Mask : ハード・マスク)**  
PVD等で成膜されたマスク層

**ULVAC**